

株式会社タムラ製作所

2014年3月期 第2四半期決算概要

2013年11月8日



TAMURA

Your One and Only Company

1. 2014年3月期 第2四半期決算概要
2. 2014年3月期 通期業績予想

1. 2014年3月期 第2四半期決算概要

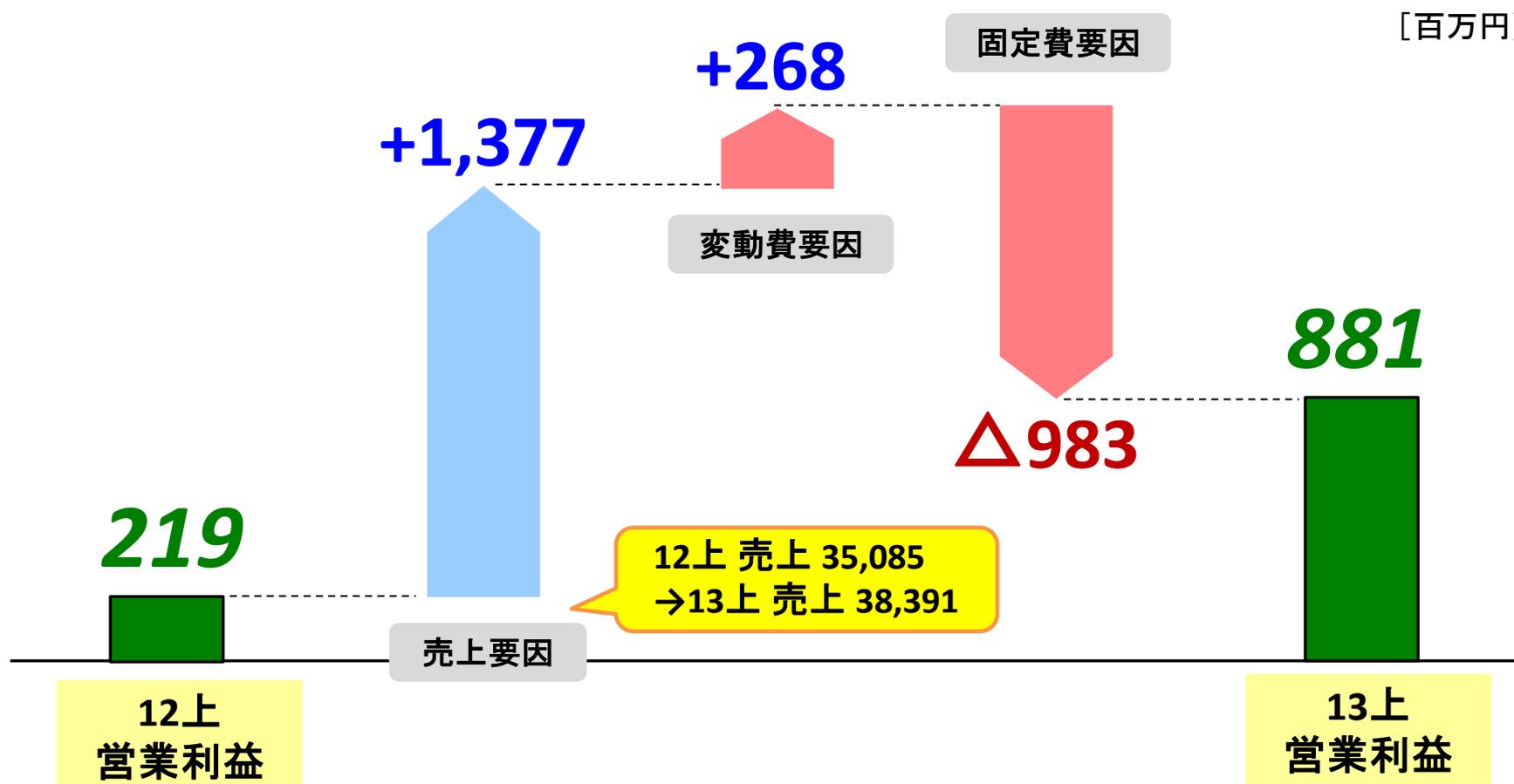
- 緩やかな景気回復のもと、戦略事業の伸長と構造改革効果により利益拡大
- 為替差益の計上により、経常利益・税引前利益・四半期純利益は大幅に増加

	[百万円]				
	FY2012 上期	FY2012 下期	FY2013 上期	前年同期 増減額	前年同期 増減率
売上高	35,085	33,828	38,391	3,306	109%
営業利益	219	342	881	662	402%
営業外損益	△139	48	328	467	—
経常利益	80	390	1,209	1,129	15倍
特別損益	△76	△617	△32	44	—
税引前損益	4	△227	1,177	1,173	294倍
四半期純損益	△198	△569	734	932	—

13上 期中平均実績為替レート \$1= 97円86銭
 13上 期中平均社内為替レート \$1= 98円17銭
 13上 期末日実績為替レート \$1= 97円75銭
 13上 期首計画為替レート \$1= 94円

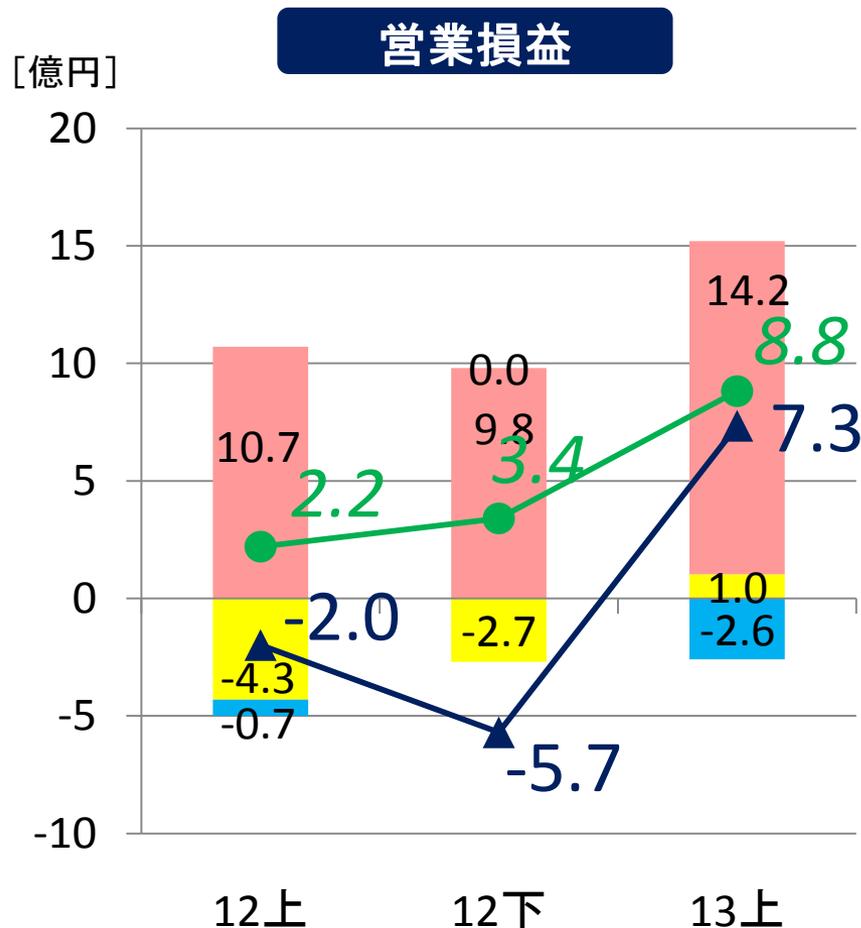
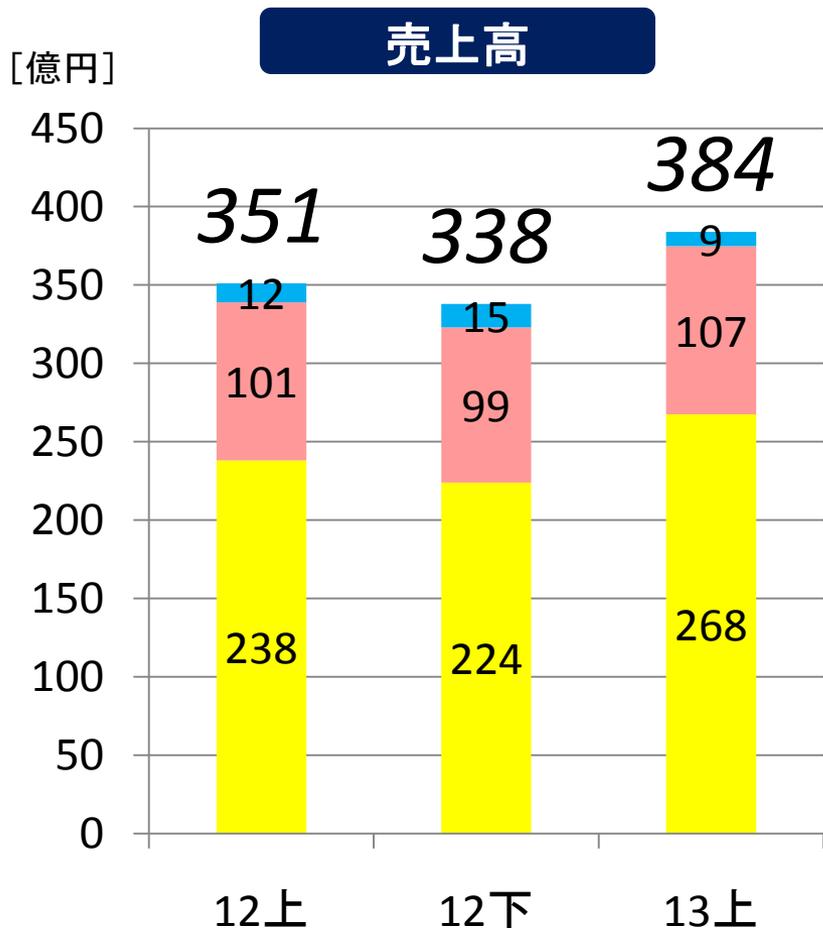
損益の増減分析

- 為替変動の影響により、前年同期比較で売上および固定費金額が増加
- 円安は原材料や海外生産品の輸入ではマイナス要因となったが、営業面・生産面から企業努力を進め、影響を最小限におさえる。
- 高付加価値製品の拡大により変動費率は低下し、収益性アップ



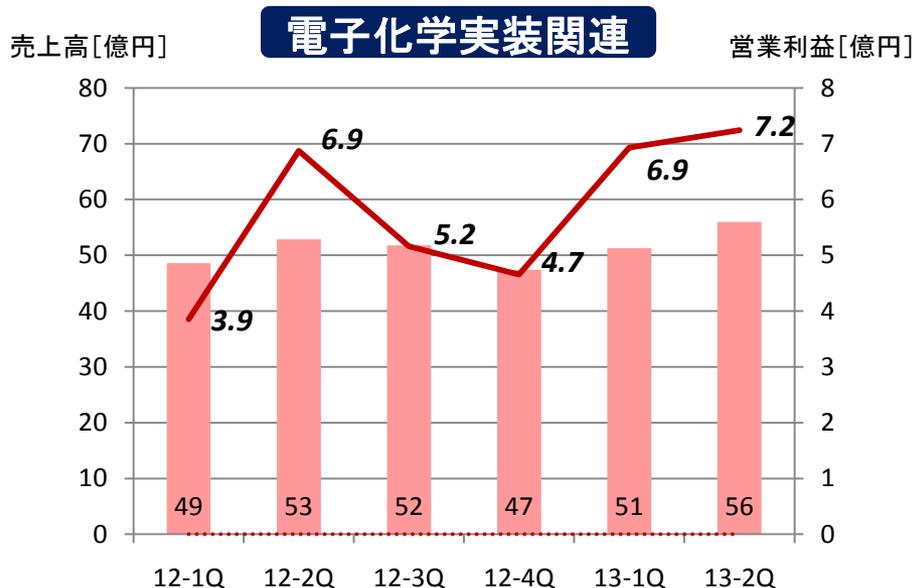
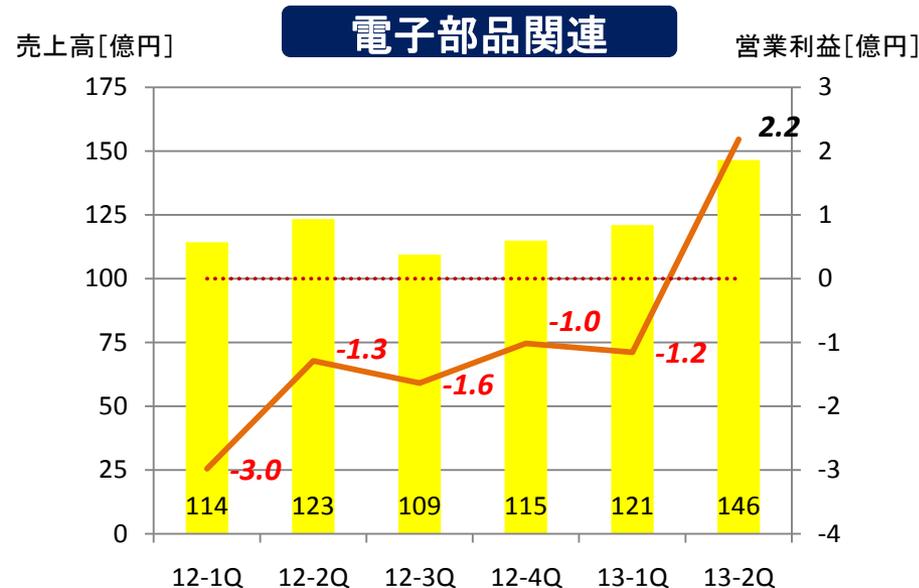
事業部門別の売上高・損益推移

- 電子部品： ターゲット市場の売上増加と構造改革効果で、黒字転換
- 電子化学実装： 戦略市場向け製品の伸長で、利益拡大
- 情報機器： 低迷する設備投資需要を背景に売上が大幅に減少し、収益悪化



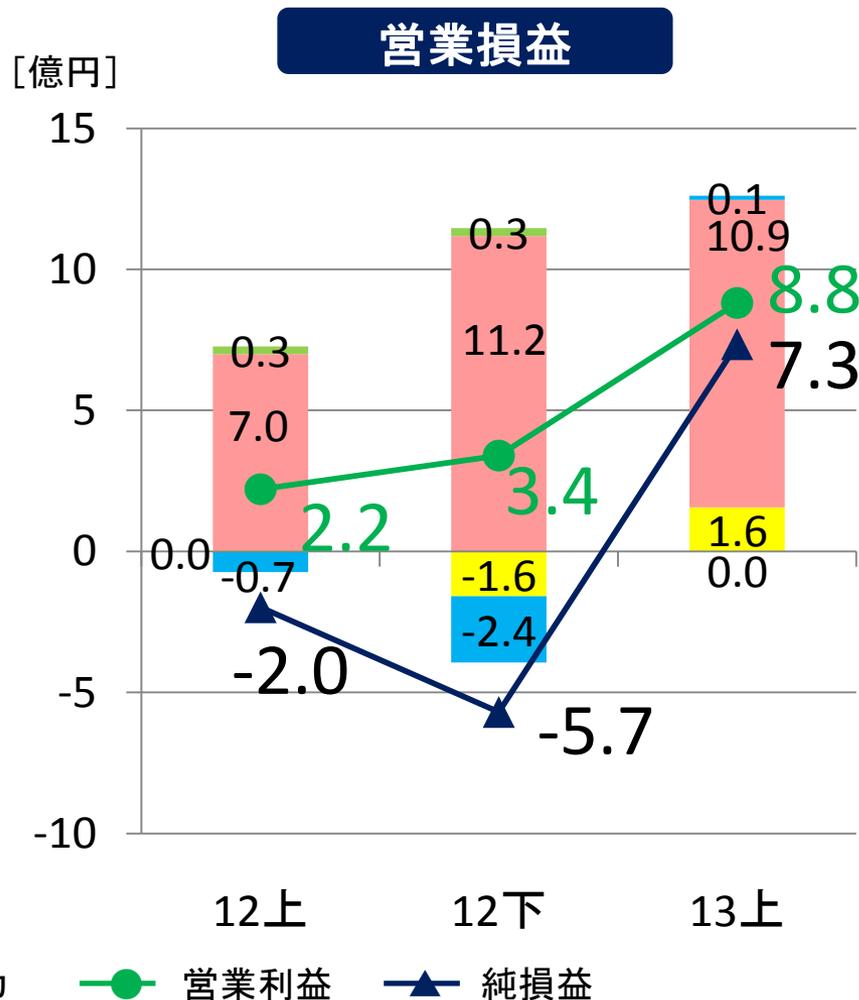
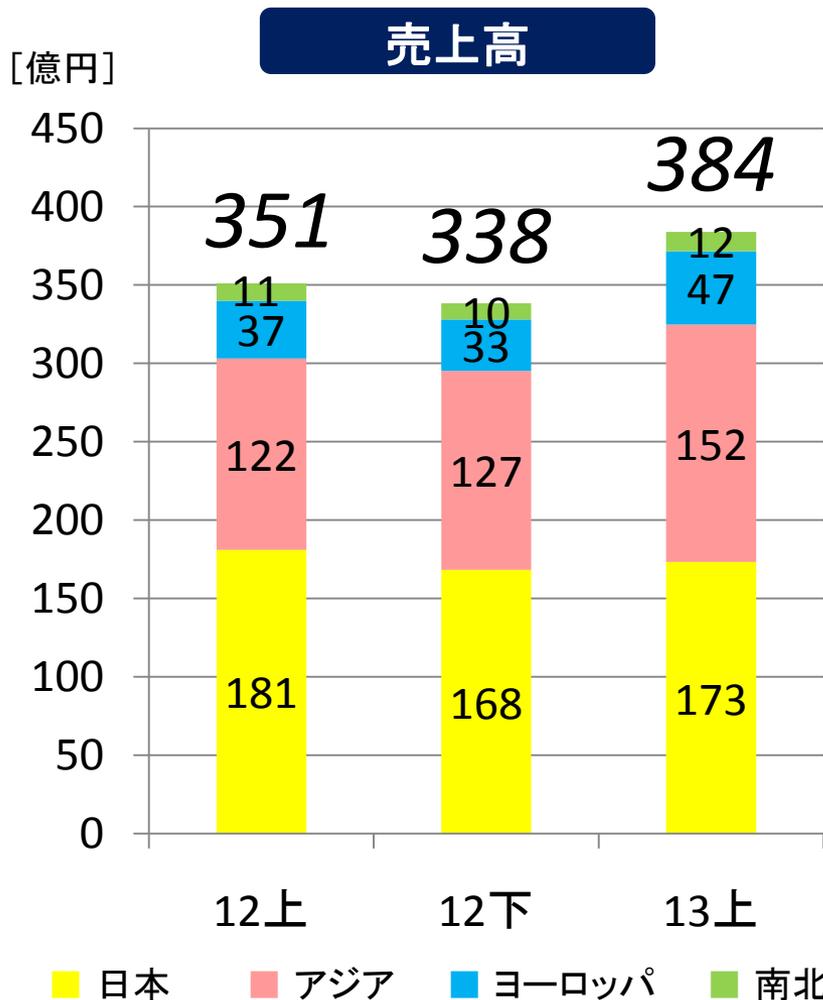
■ 電子部品関連事業 ■ 電子化学実装関連事業 ■ 情報機器関連事業 ● 営業利益 ▲ 純損益

事業部門別の売上高・損益(四半期推移)

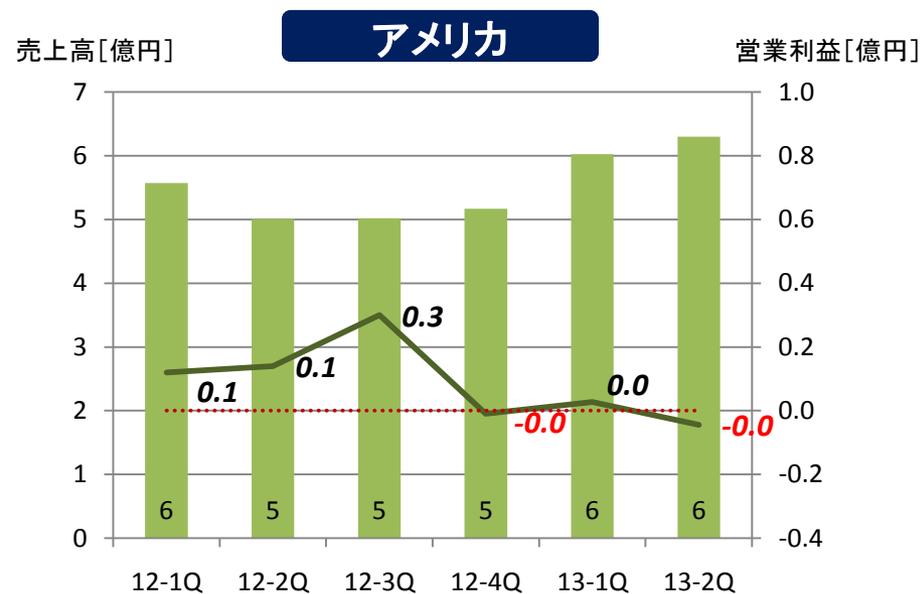
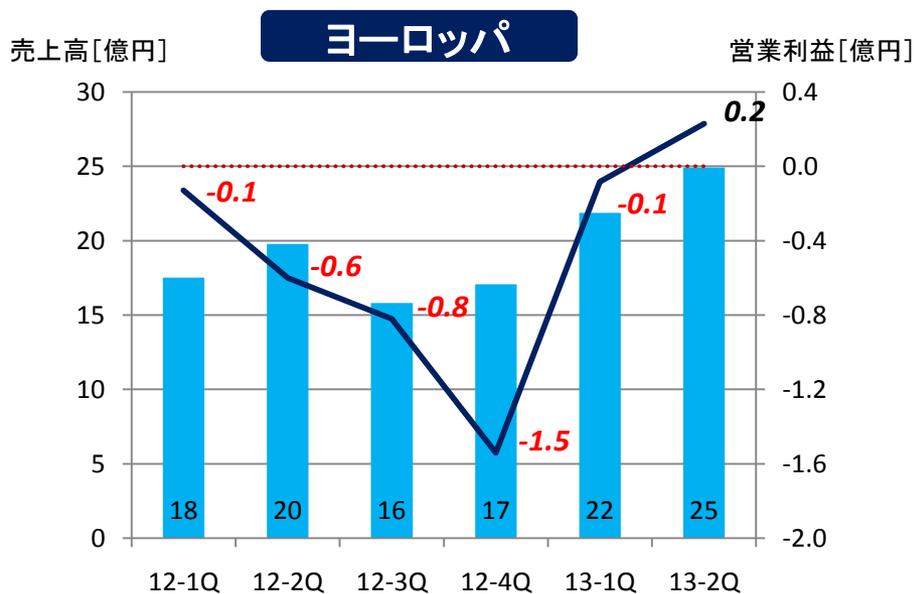
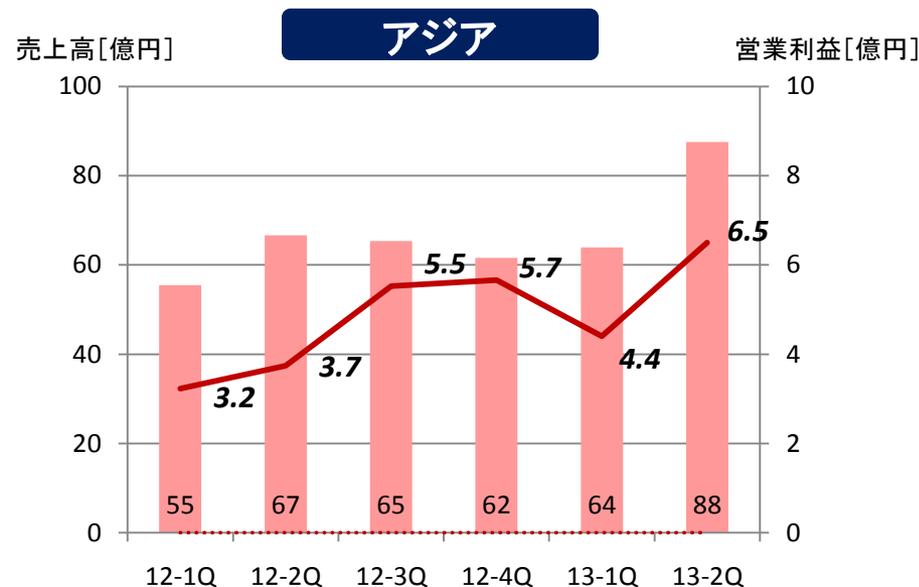
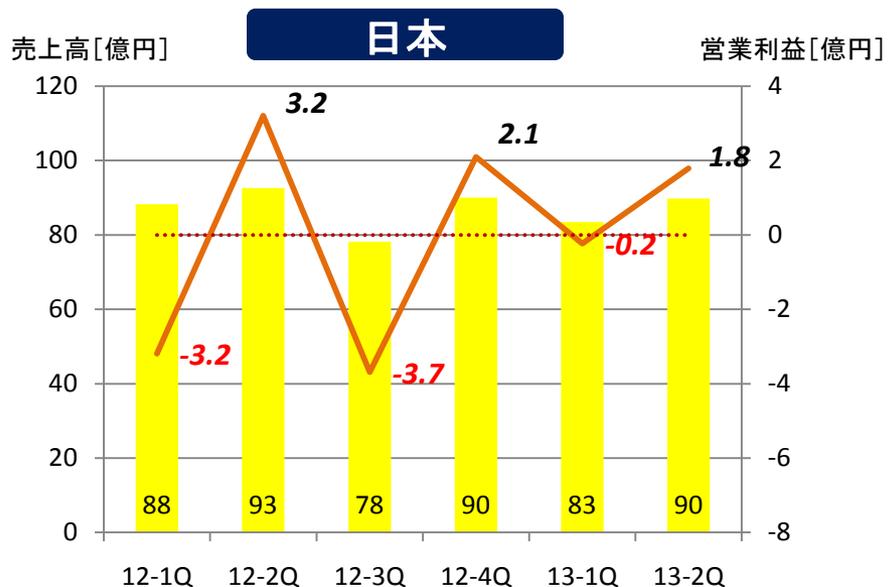


地域別の売上高・損益推移

- 日本：市場が回復傾向で推移し、高付加価値製品の拡大で、黒字転換
- アジア：中国市場を中心に堅調に推移
- 欧米：ヨーロッパはエネルギー市場向けの売上が伸長し、収益改善



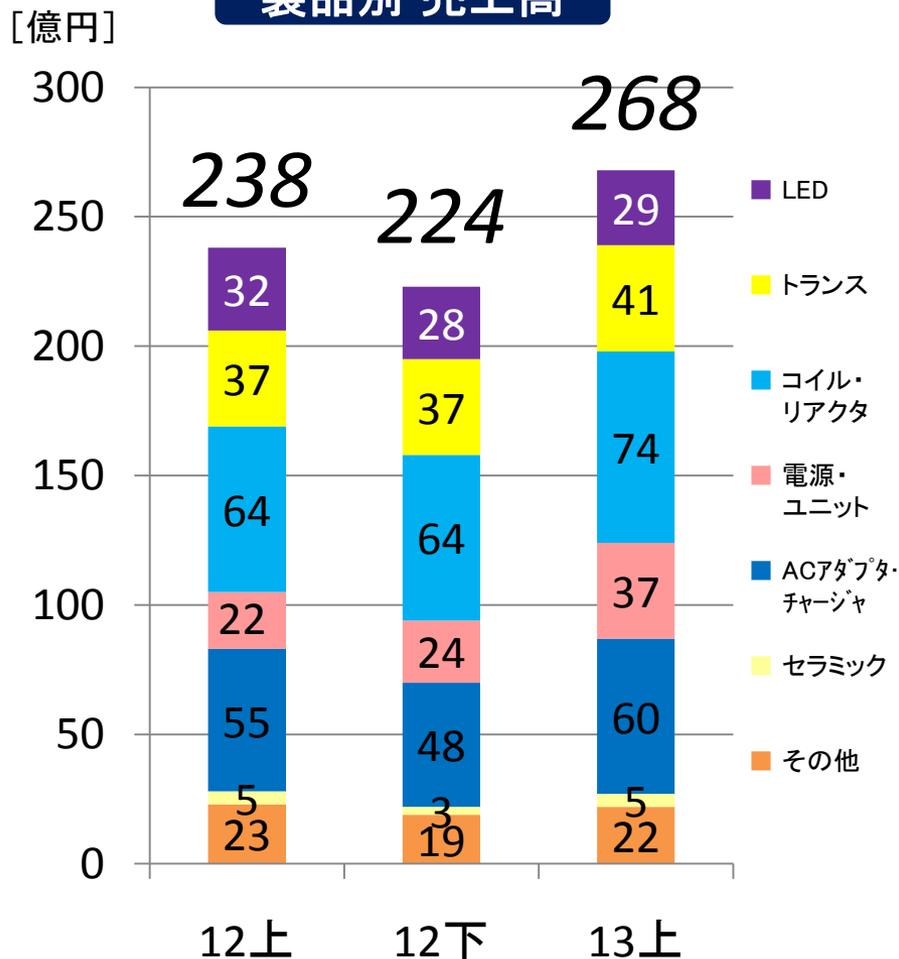
地域別の売上高・損益(四半期推移)



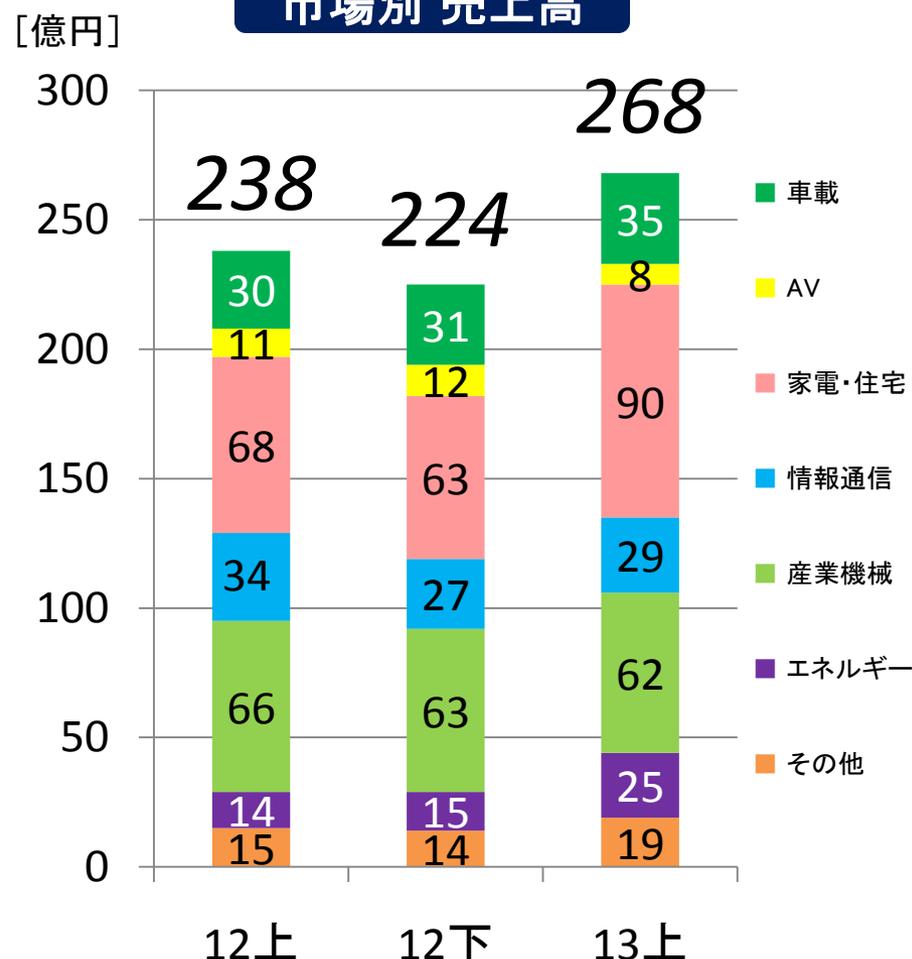
電子部品関連事業の売上高推移

- 家電住宅市場が、電動工具や猛暑を背景にしたエアコン関連などを中心に好調
- パソコン用リアクタや、LED街路灯用電源など、エネルギー関連が伸長
- 製品別では、エアコン・エネルギー・車載などの各分野でキーとなるリアクタが堅調

製品別 売上高

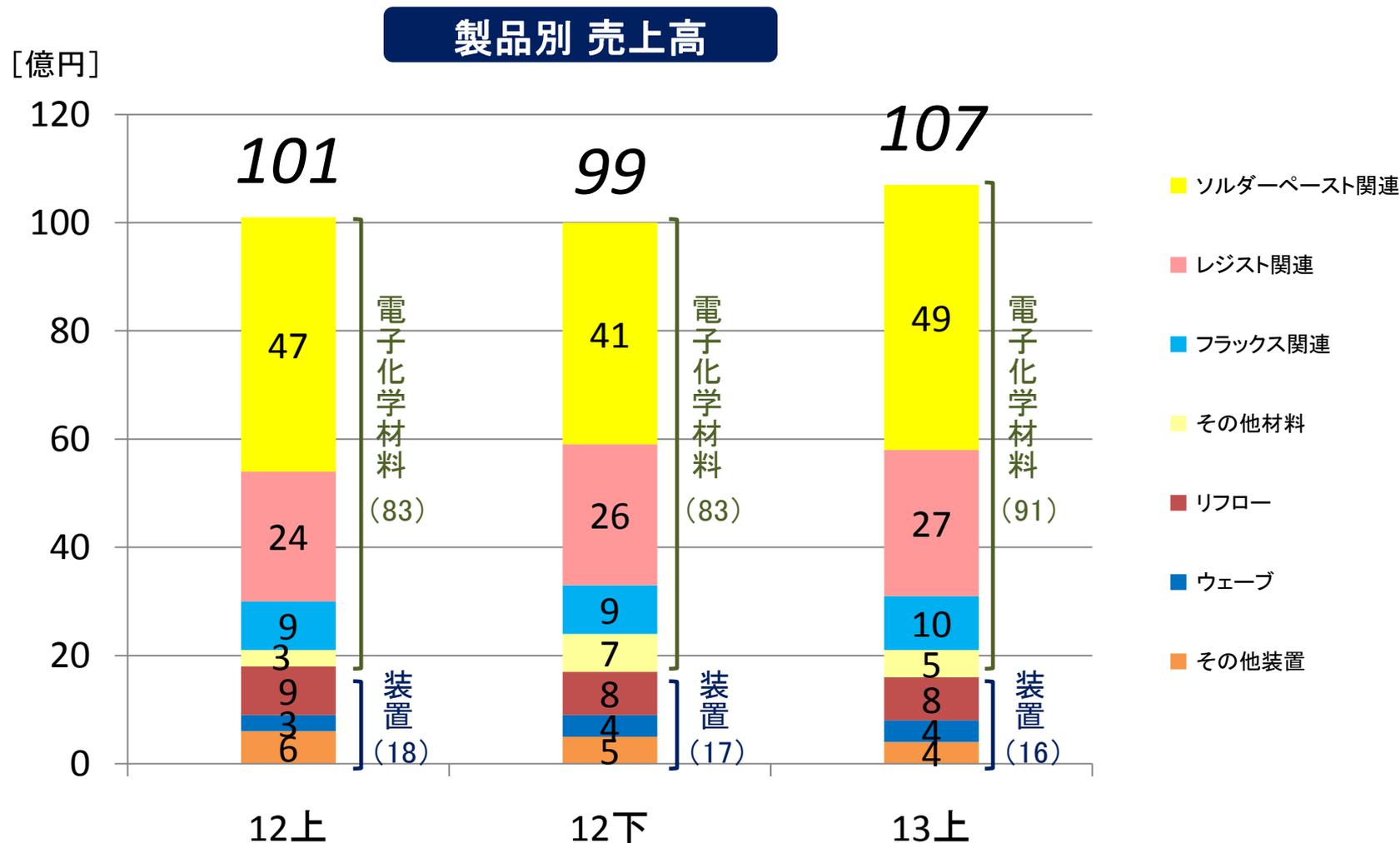


市場別 売上高



電子化学実装関連事業の売上高推移

- 電子化学事業は、車載用材料や、スマートフォン向けフレキシブル基板用ソルダーレジストなどが、市場のニーズに応じて堅調に推移
- 設備投資需要は国内外で低調で、実装装置事業は苦戦



貸借対照表(要約)

- 総資産は52.3億円増加（棚卸資産+14.5億円、有形固定資産16.2億円）
- 有利子負債が20.3億円増加、純資産は為替調整戻しが寄与し29.5億円増加

[百万円]

	12/9	13/3	13/9	対13/3	
流動資産	43,811	43,775	46,817	3,042	
（現預金）	11,323	10,104	10,819	715	
（売上債権）	19,766	20,096	20,574	477	
（棚卸資産）	10,583	11,322	12,775	1,453	※1
（その他流動資産）	2,138	2,253	2,648	396	
固定資産	21,498	22,882	25,067	2,184	
（有形固定資産）	16,680	17,356	18,973	1,616	※2
（無形固定資産）	1,420	1,475	1,443	△31	
（投資、その他）	3,396	4,050	4,650	599	
資産合計	65,310	66,658	71,884	5,226	
流動負債	24,505	29,690	27,833	△1,856	
（仕入債務）	10,625	10,669	11,420	751	
固定負債	13,132	8,832	12,964	4,132	
〔有利子負債〕	21,236	20,758	22,791	2,032	※3
負債計	37,638	38,522	40,798	2,275	
純資産合計	27,671	28,135	31,086	2,951	※4
負債・純資産合計	65,310	66,658	71,884	5,226	

■ 主な増減

※1 棚卸資産 +1,453

※2 有形固定資産 +1,616

うち児玉新工場 +1,114

※3 有利子負債 +2,032

うち児玉新工場借入金 +1,500

※4 純資産 +2,951

うち当期純利益 +734
為替換算調整 +1,861

キャッシュフロー(要約)

- 営業CF: 税前利益大幅増加11.8億円も
[在庫増加9.6億円、前期計上未払希望退職支払7.6億円]により対前年同期比では低水準
- 投資CF: 設備投資が増加(児玉新工場他)
- 財務CF: 設備投資資金を借入(児玉新工場他)

	12上	12下	13上	[百万円] 前年同期 増減額
営業活動によるキャッシュフロー	2,984	646	742	△2,242
投資活動によるキャッシュフロー	△800	△915	△2,427	△1,627
フリーキャッシュフロー	2,184	△269	△1,685	△3,869
財務活動によるキャッシュフロー	△636	△1,323	1,713	2,349
キャッシュの増減	1,531	△1,242	588	△943
キャッシュの残高	11,185	9,943	10,619	△566

2. 2014年3月期 通期業績予想

- 第2四半期累計期間における実績及び今後の見通しを考慮して、平成25年5月10日に公表した通期業績予想の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益をそれぞれ上方修正

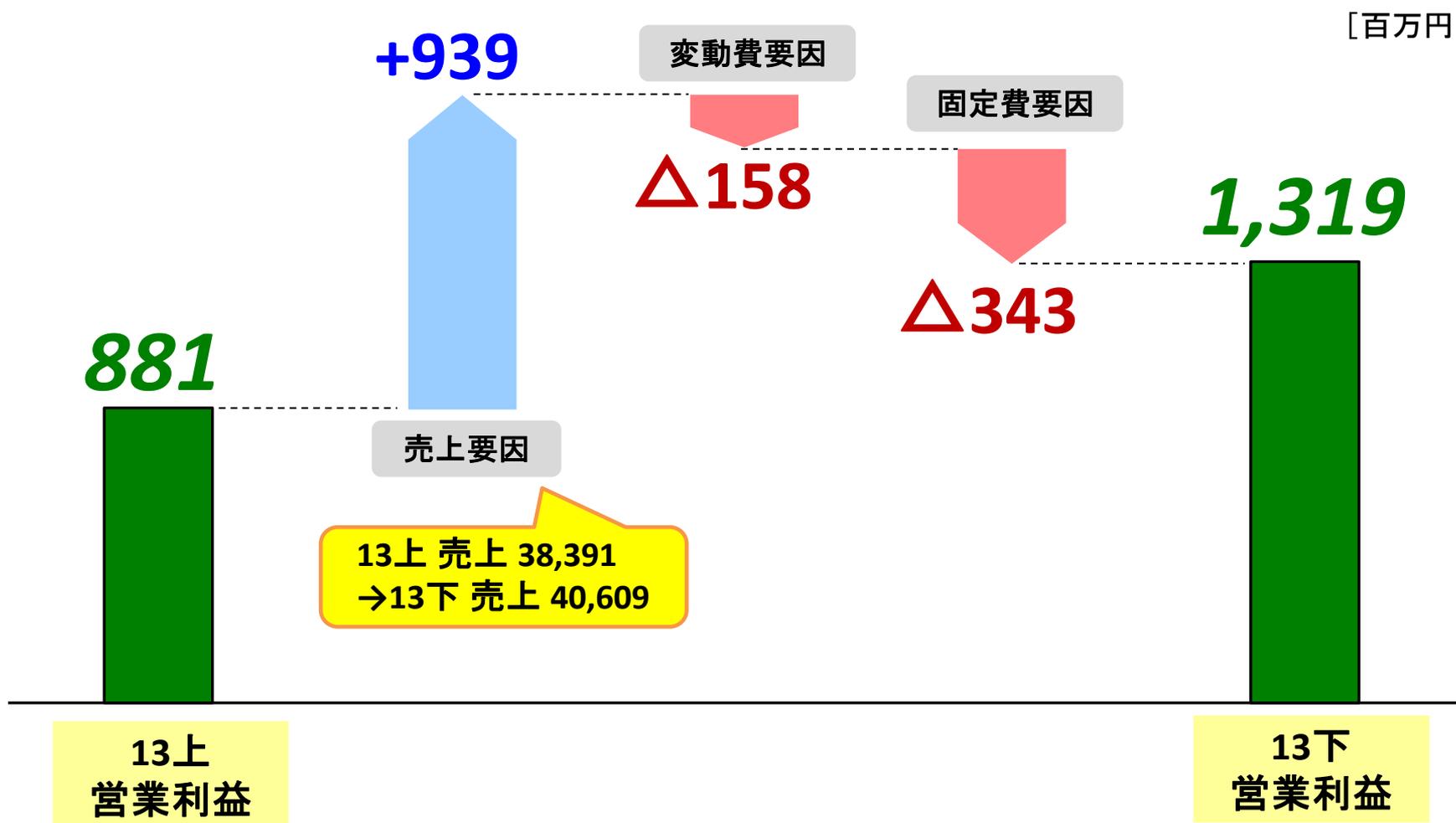
[百万円]

	FY2012 通期 実績	FY2013 上期 実績	FY2013 下期 修正予想	FY2013 通期 修正予想	対前年 増減額	対前年 増減率	参考) FY2013 通期 期首予想
売上高	68,913	38,391	40,609	79,000	10,087	115%	77,000
営業利益	561	881	1,319	2,200	1,639	392%	2,100
経常利益	470	1,209	1,091	2,300	1,830	489%	1,800
当期純損益	△767	734	766	1,500	2,267	—	1,200

13下期 計画為替レート \$1= 100円

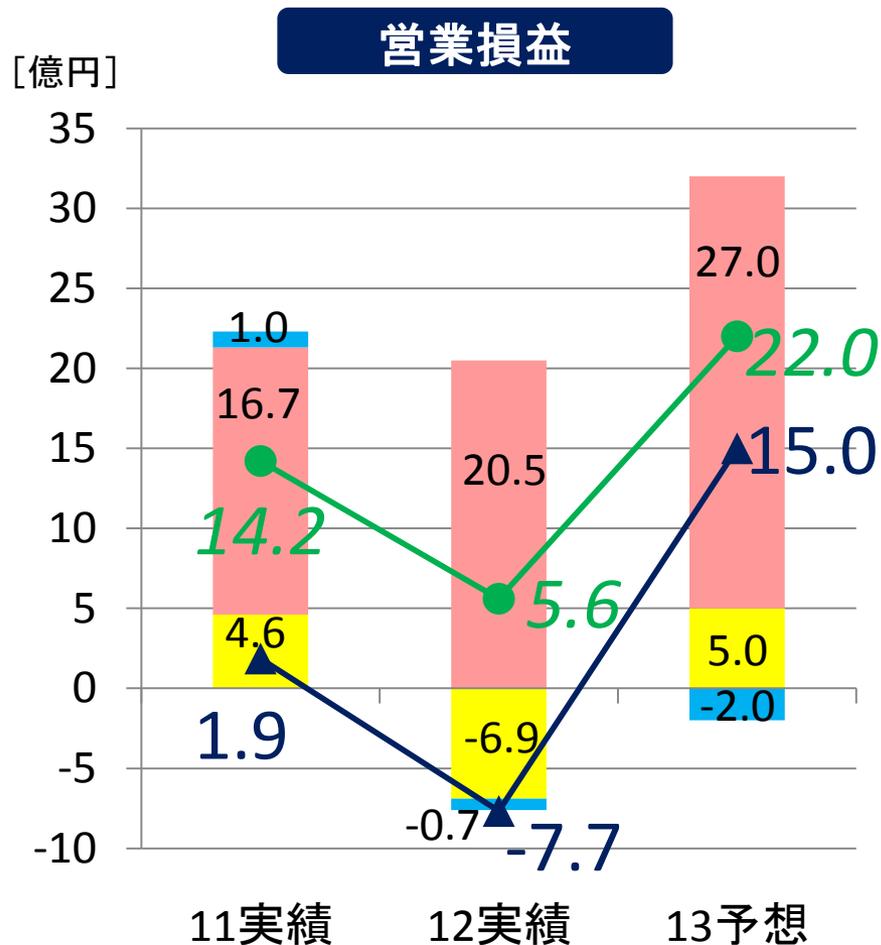
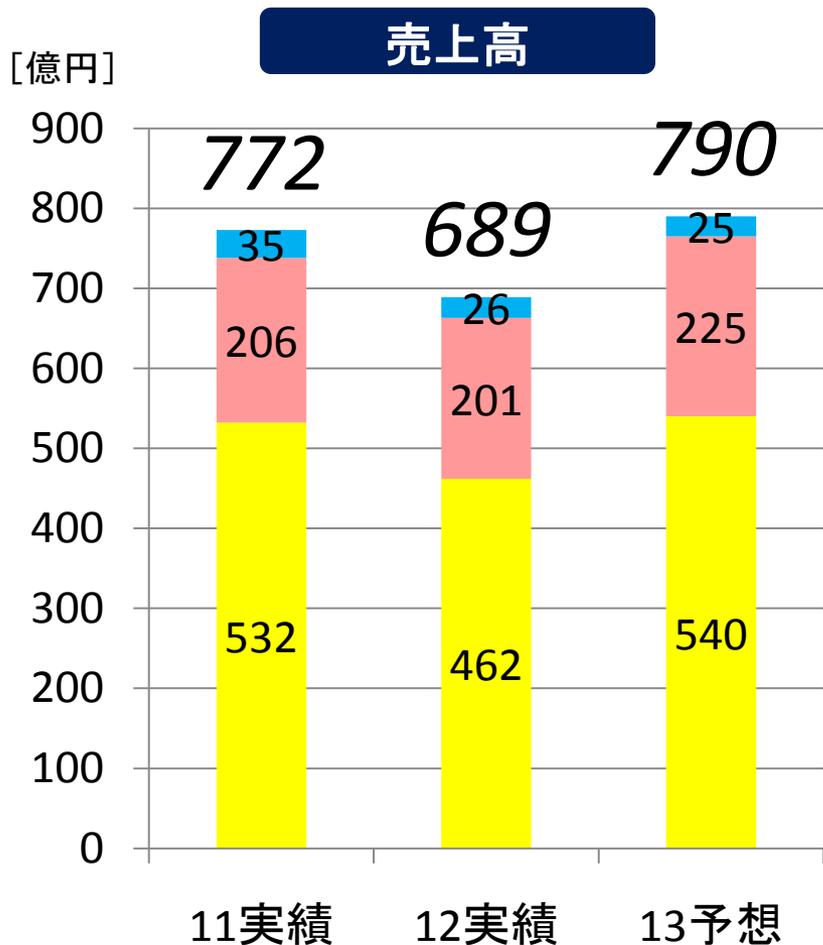
参考) 期首 計画為替レート \$1= 94円

- 売上増加に伴うコスト上昇は、営業面・生産面からの企業努力で最小化を図る
- 2013年10月に完成した児玉新工場に関する諸経費が発生



事業部門別の売上高・損益見通し(年次)

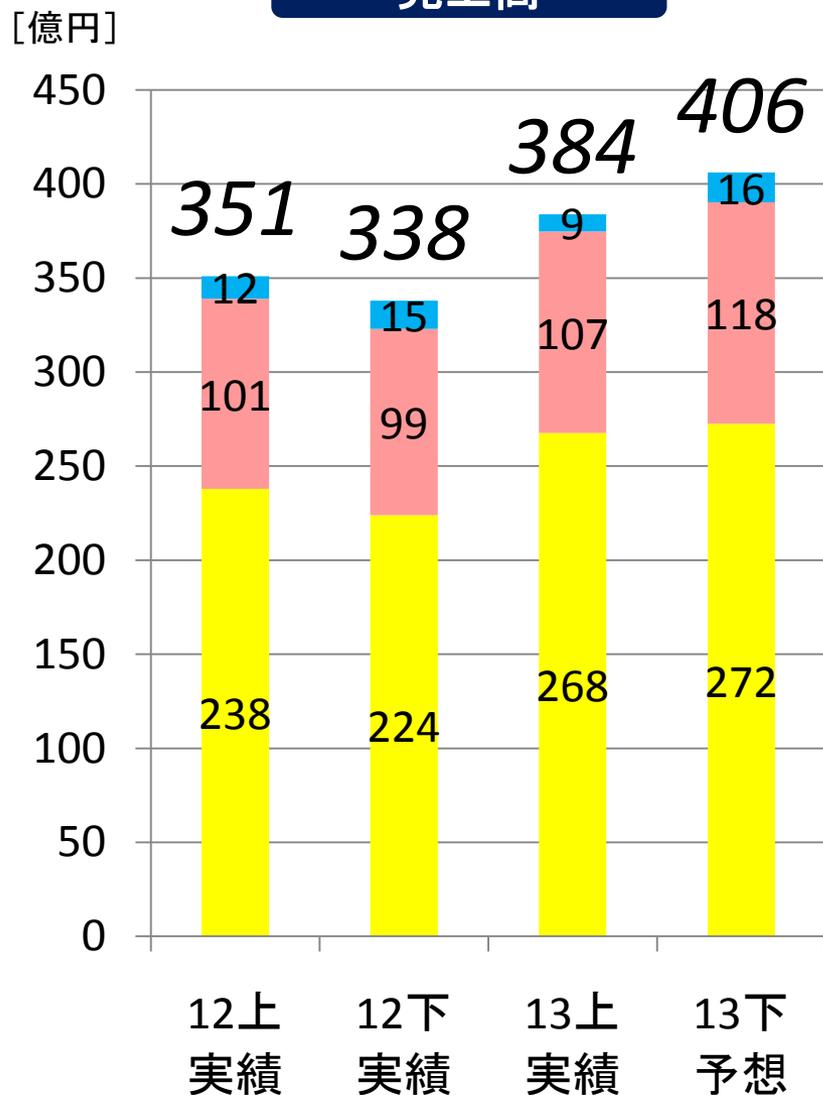
- 電子部品： 安定収益体制を確立、ターゲット市場の売上を拡大
- 電子化学実装： 高付加価値製品の伸長で、利益を拡大
- 情報機器： 市場環境は引き続き厳しいが、新モデルの拡販で挽回を図る



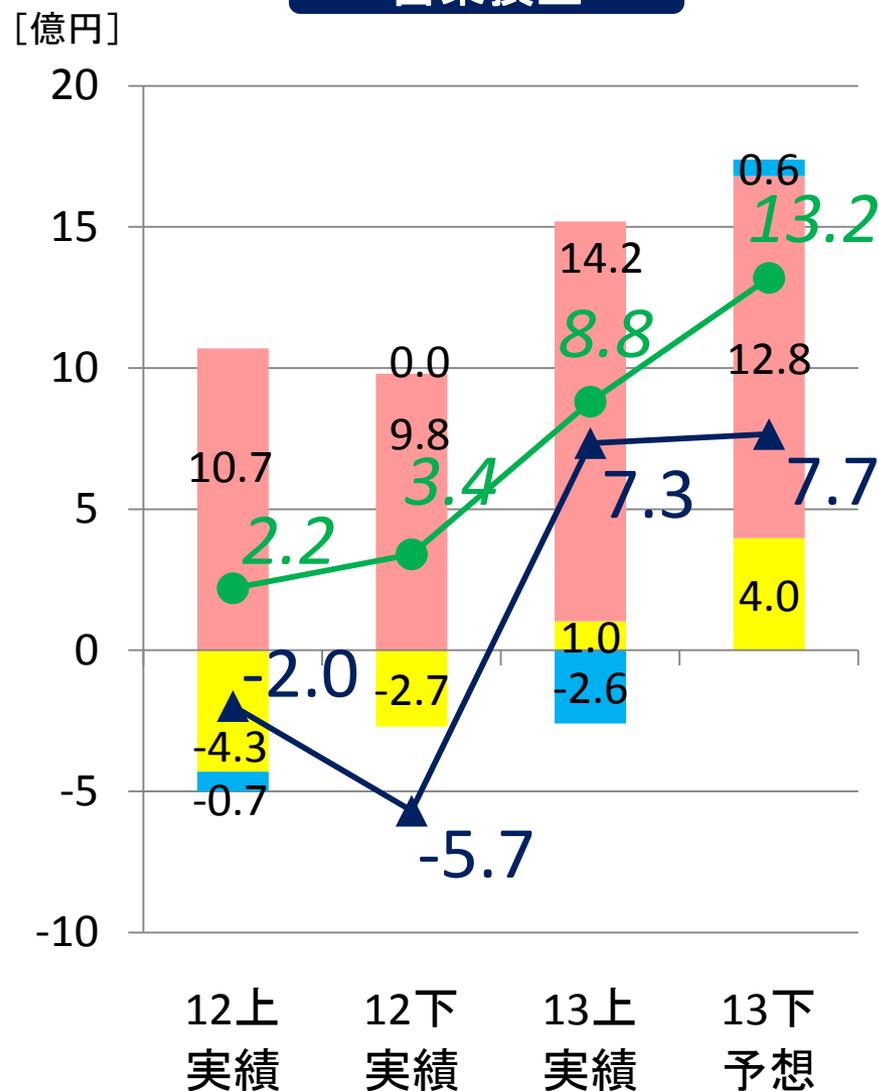
■ 電子部品関連事業 ■ 電子化学実装関連事業 ■ 情報機器関連事業 ● 営業利益 ▲ 純損益

事業部門別の売上高・損益見通し(半期)

売上高



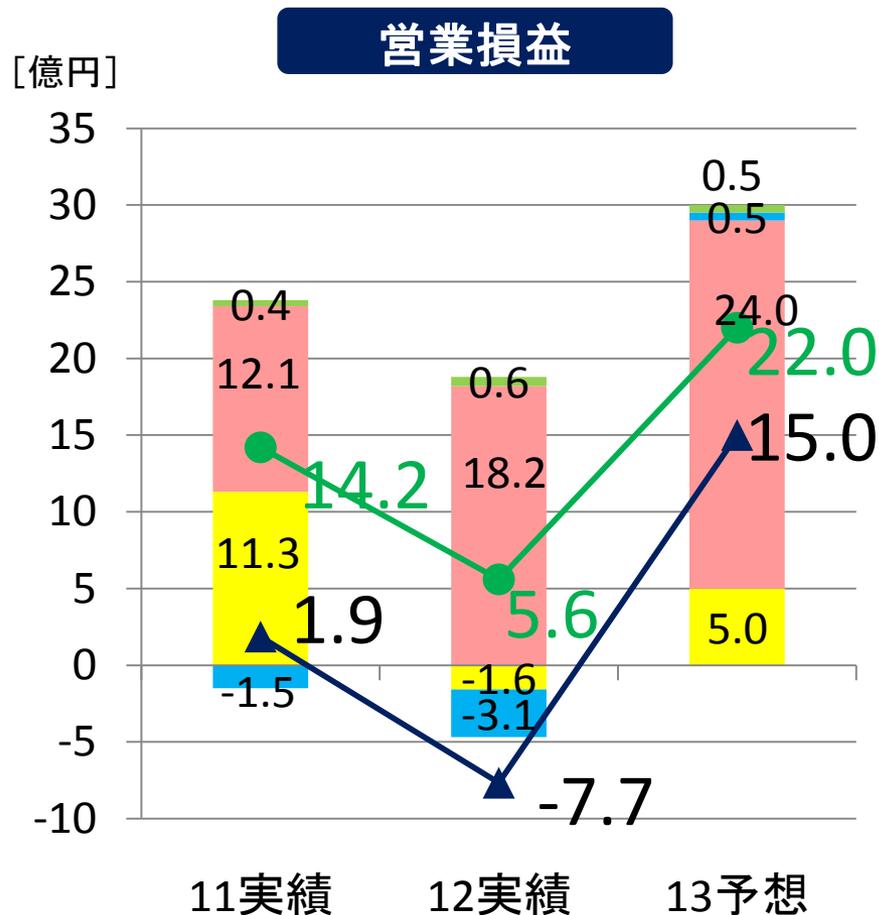
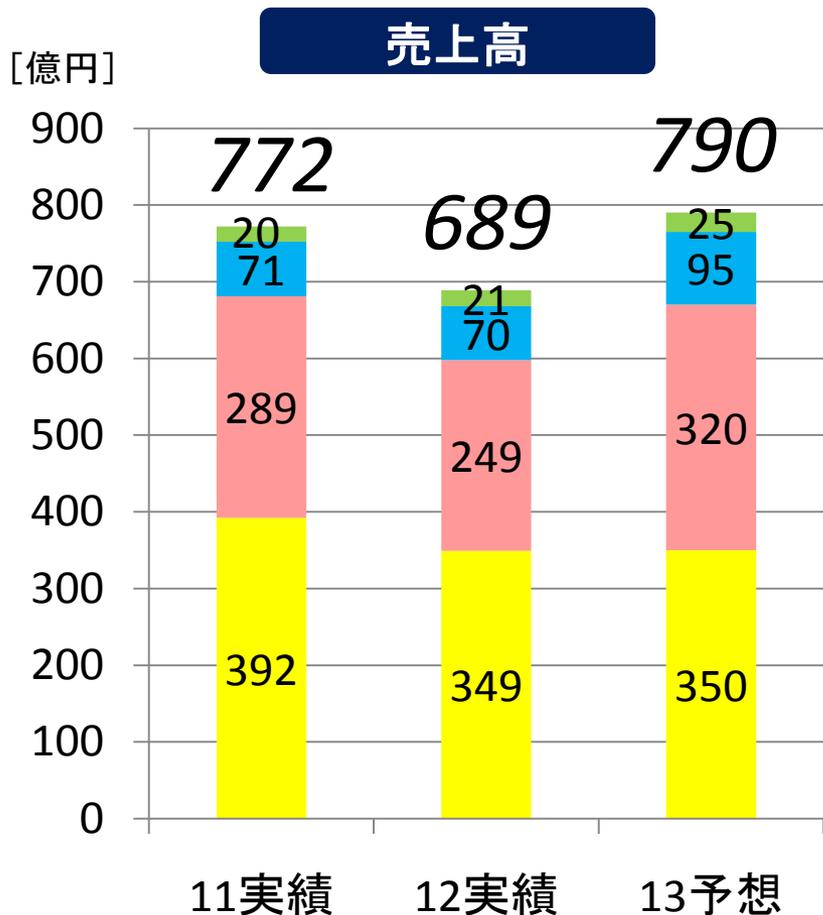
営業損益



■ 電子部品関連事業
 ■ 電子化学実装関連事業
 ■ 情報機器関連事業
 ● 営業利益
 ▲ 純損益

地域別の売上高・損益見通し

- 日本： 省エネや高機能化のニーズに応える、高付加価値製品の販売を拡大
- アジア： “China+1” 生産体制構築を進め、更なる効率化と収益向上を目指す
- 欧米： エネルギー関連を中心に、非日系顧客への販売を強化

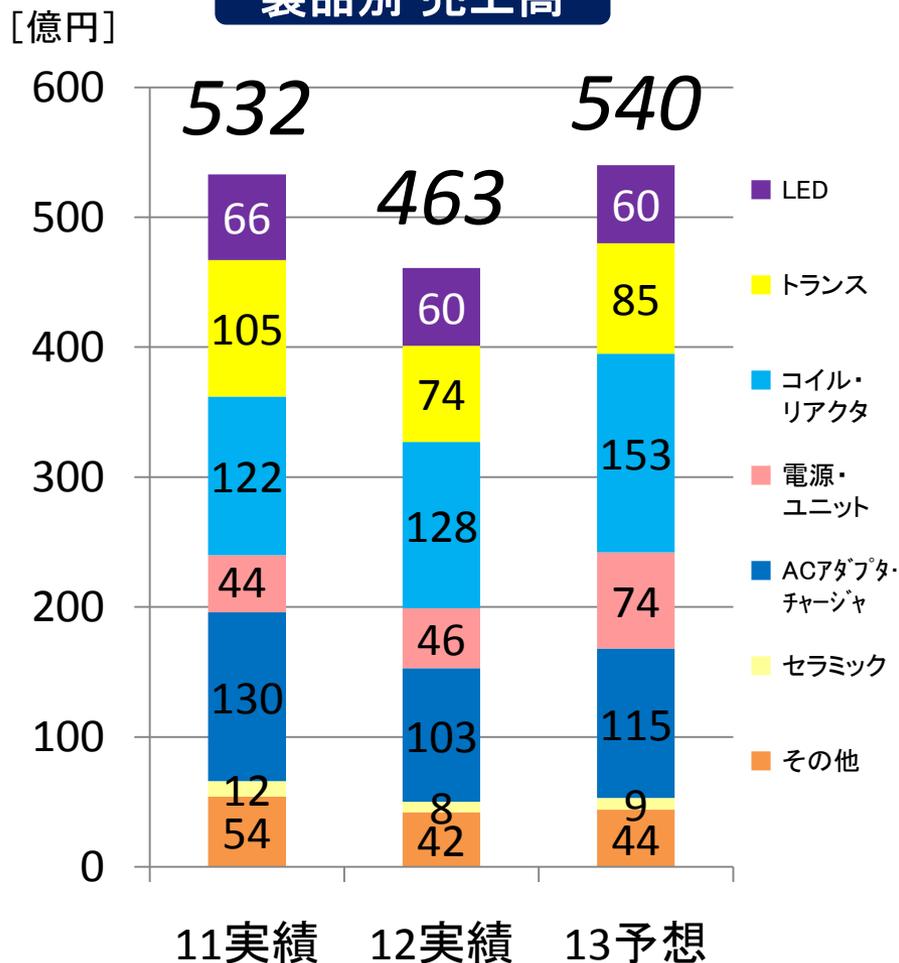


■ 日本
 ■ アジア
 ■ ヨーロッパ
 ■ 南北アメリカ
 ● 営業利益
 ▲ 純損益

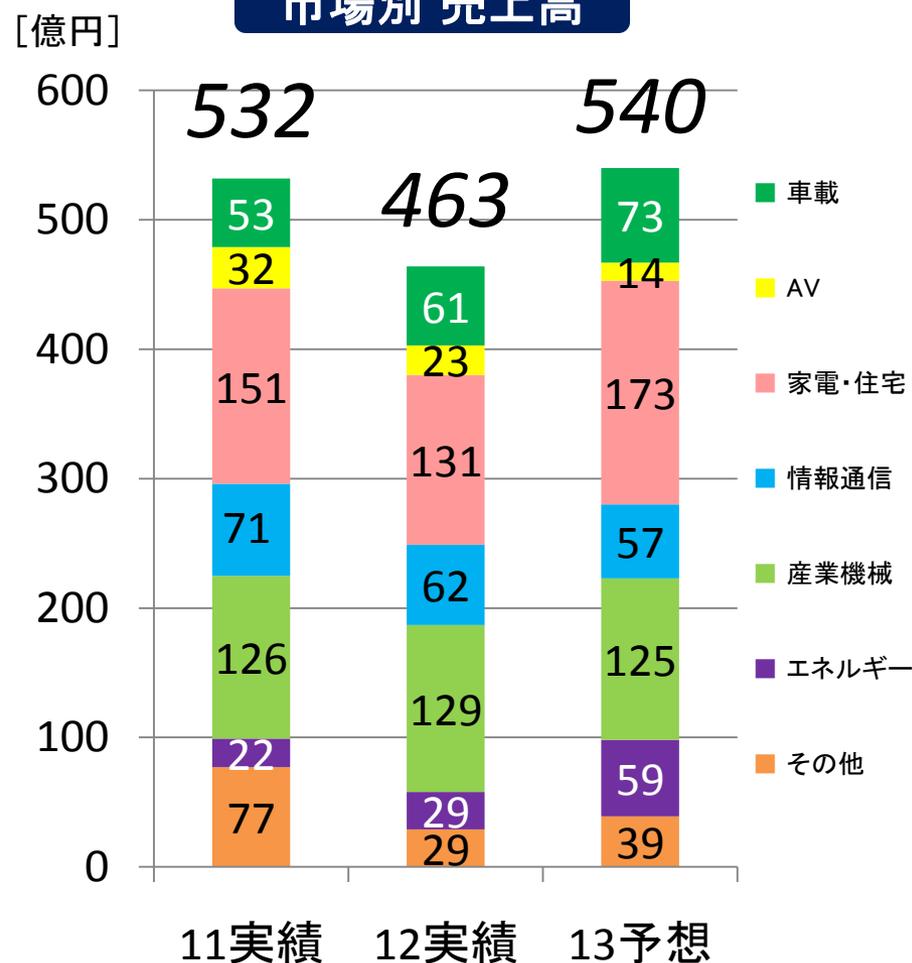
電子部品関連事業の見通し

- 収益確保を第一に、ターゲット市場へ集中
- エネルギー市場向け製品のグローバル展開を推進
- コア材からの開発で、製品競争力と付加価値をアップ

製品別 売上高

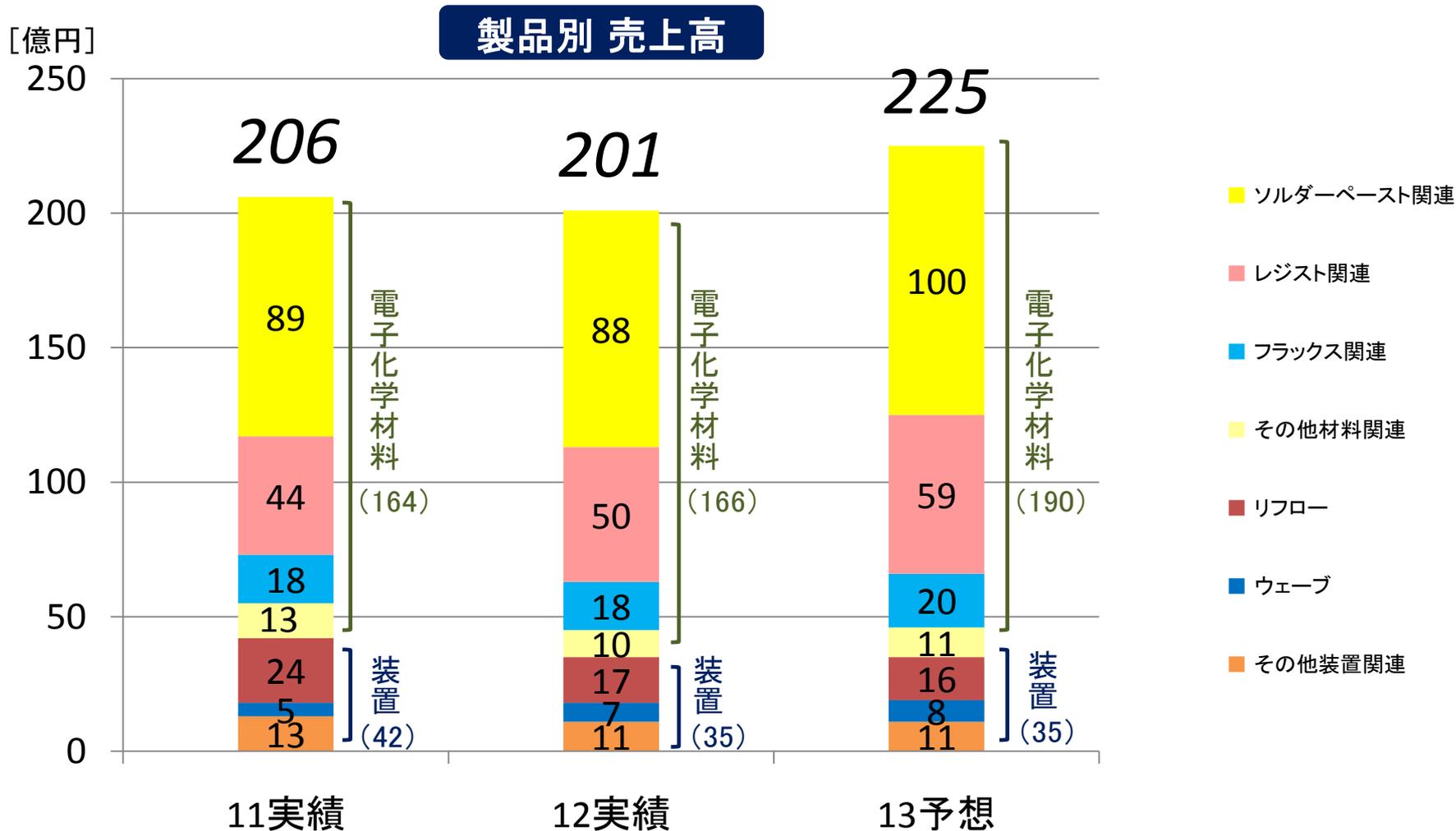


市場別 売上高



電子化学実装関連事業の見通し

- 電子化学事業は、伸長するスマートフォン・タブレットPC市場、車載市場をターゲットに新規顧客開拓、新製品開発を加速
- 厳しい市場環境が続く実装装置事業は、顧客訪問を強化し保守サービス活動でカバー



■ 電子部品関連

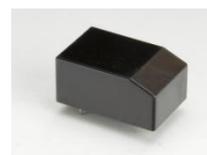
PVリアクタ (高性能標準タイプ高周波リアクタ)

家庭用パワーコンディショナーに最適な標準レンジを設定した「PVリアクタ」をリリース。形状バリエーションと3つのグレードからお客様の設計にあわせた商品を選択できます。新製品として、アモルファス圧粉磁心による低損失、高飽和磁束の圧粉磁心を用いたELDシリーズと従来のケース入り圧粉コアから、小型化、低DCR化が可能な樹脂コーティングタイプの圧粉コアをラインナップしました。



高効率電源モジュール

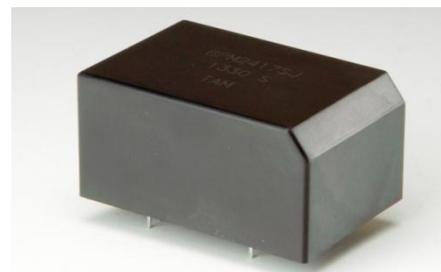
「高効率電源モジュール」は、低待機電力かつ高効率電源の設計を容易に実現し、設計期間短縮、開発費の削減に貢献する製品です。各用途に合わせて豊富なラインナップを揃えております。



SPMシリーズ
4W以下に最適



EPMシリーズ
15W以下に最適



EPMシリーズ
40W以下に最適

■ 電子化学関連

透明フレキシブル絶縁材料 JIMシリーズ・TOMシリーズ

有機物、無機物のどちらにでも対応でき、なおかつ印刷とインクジェット方式のどちらにも対応できるフレキシブルな透明の絶縁材料のシリーズです。



フレキシブル基板向けソルダーレジスト PAFシリーズ

ハロゲンフリーで豊富なカラーバリエーションに対応します。



APBシリーズ

黒色でマットな質感で配線をかすことができます。



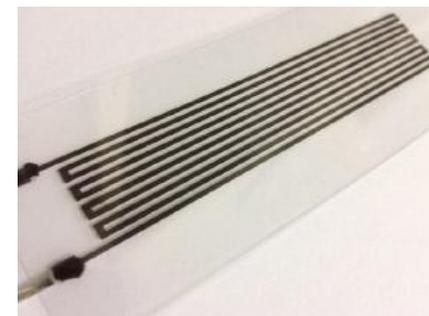
レーザーはんだ付け用ソルダーペースト LSMシリーズ

ディスペンス工法によるはんだ局所定量供給とレーザーでの局所加熱において、フラックスの広がりや飛び散りを最小限に抑えた局所はんだ付けに最適なレーザーはんだ付けに対応したSAC305組成のハロゲンフリーソルダーペーストです。



低温硬化導電性接着剤 LICA

低アウトガス、低光反射特性で80°Cで硬化可能な接合材。カメラモジュールや熱に敏感な半導体、MEMS等の接合にも対応できます。



■ 実装装置関連

ポイントディップ TPシリーズ

タムラ新製品ポイントディップシリーズとして

トレースプレー：TPF25-85T

プリヒーター：TPH25-85

セレクトィブはんだ槽：TPW25-85S

トレースはんだ槽：TPW25-85T

の4製品をリリースしました。

新シリーズは、あらゆる分野にフレキシブルに対応できる
レイアウトフリー設計で、モジュール増設時の拡張も
可能となっています。



リフローはんだ付装置 TNVシリーズ

「省エネ」、「省電力」、「省N2消費量」を特徴とする
TNVシリーズは家電、照明、車載、携帯電話、医療用と
多くの分野の実装に対応可能で、豊富なラインナップを
取り揃えております。

中国深圳市で2013年8月に開催された展示会「Nepcon
South China」で、新型リフロー装置を初出展。
流線型の革新的な外観デザインと、更なる省エネ技術に、
中国市場でも注目が集まりました。



■ 情報機器関連

デジタル音声卓(ミキサー) NT660

今まで培ってきた技術力を集結した音声卓の最上位機種「NT880」の機能と安全性を活かしながら、新たな操作方式の採用により小型化した「NT660」。

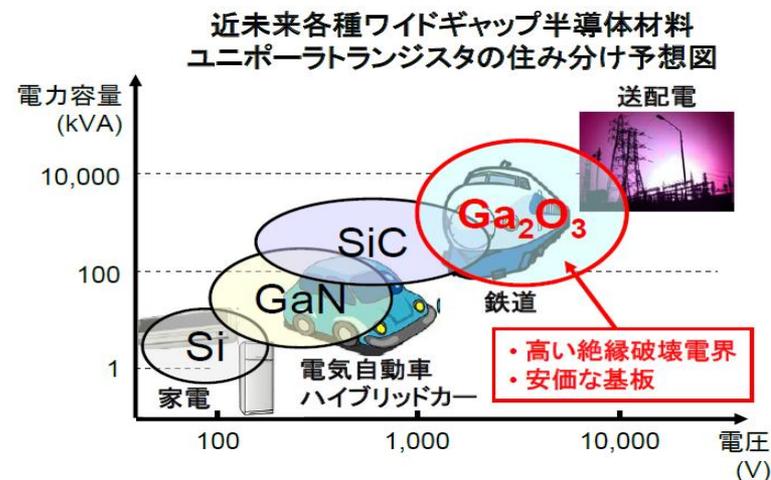
NT660はサイズのコンパクト化により、中継車や中小規模スタジオにも最適なサイズの音声卓として、既に国内外で多数の引き合いをいただいています。



■ セミコン関連

酸化ガリウム(Ga_2O_3) MOSTランジスタ

タムラ製作所とグループ会社の光波は、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)と共同で、新しいワイドギャップ半導体材料である酸化ガリウムを用いた実用性に優れたMOSTランジスタの開発を世界に先駆けて成功しました。酸化ガリウムは、そのワイドギャップに代表される材料物性から、高耐圧・低損失なパワーデバイス用途の新しい半導体材料として非常に有望です。現代の省エネルギー問題に直接貢献することができる新しい半導体デバイスとして注目されています。



スマートフォン、車載向けなどの 高機能性ソルダーレジスト・新材料の需要に対応

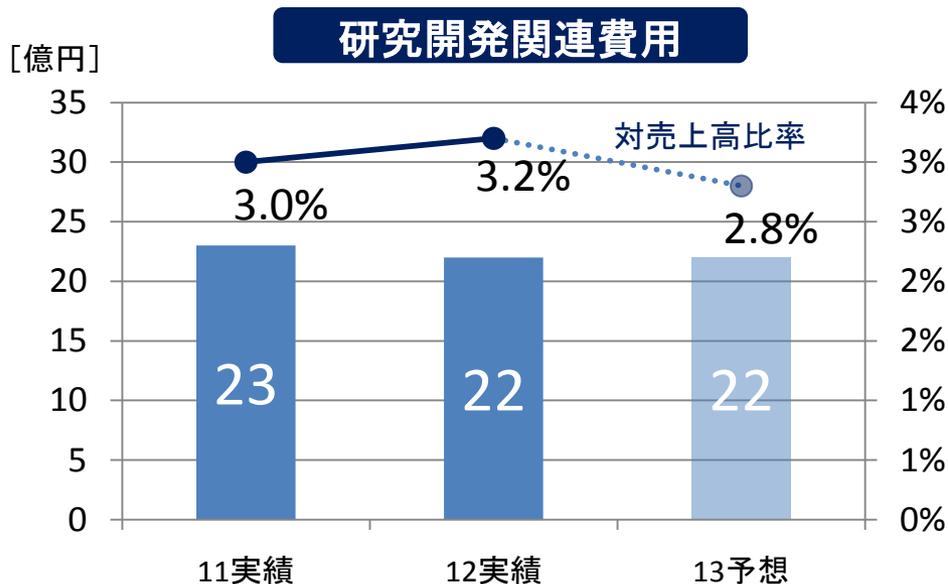
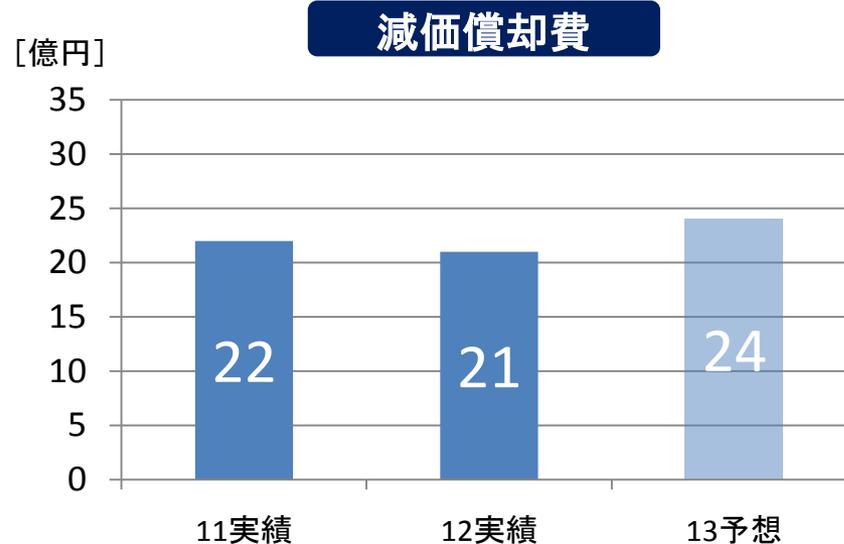
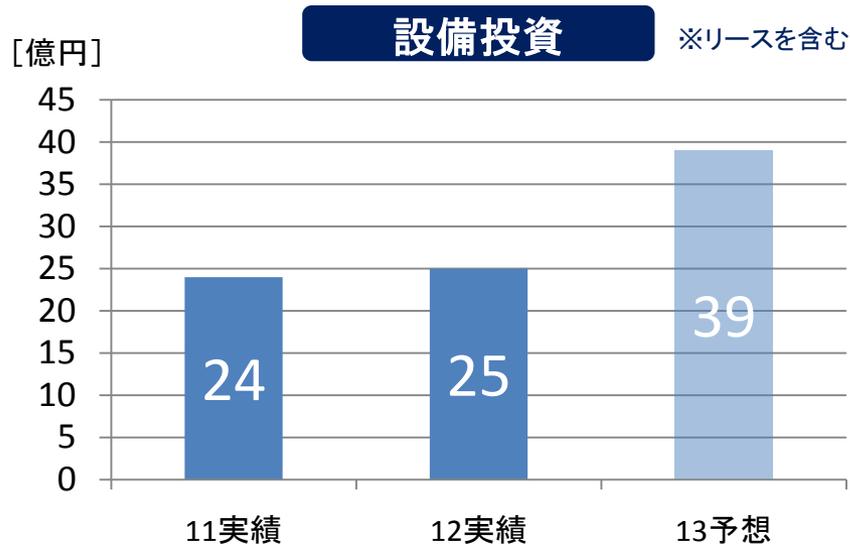
【新工場概要】

名称	タムラ製作所 児玉第二工場
所在地	埼玉県児玉郡
新棟敷地面積	5,293.6m ²
新棟建築面積	1,769.97m ²
延床面積	6,904.74m ² (鉄骨4階建)
生産品目	フレキシブル基板向けソルダーレジスト 車載用ソルダーレジスト 他





TAMURA



- #### 主な設備投資
- 電子化学: 児玉新工場関連
 - 電子部品: バングラデシュ設備増強
- #### 主な開発投資
- 電子化学材料 新素材関連
 - 車載用電子部品関連
 - 次世代デジタルワイヤレス関連
 - セミコン開発(酸化ガリウム)関連

本資料中の業績予想、見通し及び事業計画については、現時点における将来環境予測等の仮定に基づいております。本資料において当社の将来の業績を保証するものではありません。

